

证券代码：874133

证券简称：提牛科技

主办券商：华创证券

## 上海提牛科技股份有限公司

### 关于拟与上海市奉贤区金汇镇人民政府签署项目投资协议书公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、协议签署的基本情况

##### （一）协议签署情况

因公司发展需求，拟与上海市奉贤区金汇镇人民政府签署《投资协议书》。

公司于2024年3月7日召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《公司拟签署投资协议书的议案》，该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

##### （二）协议双方的基本情况

甲方名称：上海市奉贤区金汇镇人民政府（以下简称“甲方”）

甲方性质：地方政府机构

乙方名称：上海提牛科技股份有限公司（以下简称“乙方”）

甲方与乙方之间的关系：无关联关系

#### 二、协议主要内容

为了进一步扩大规模，提高产能，结合公司战略发展规划，在平等互利、协商一致的基础上，根据国家有关法律法规和政策的规定，就乙方项目达成如下协议：

公司拟投资建设厂房建筑（其中包括生产车间、配套用房、机房等），总建筑面积约3.2万平方米左右，拟用于高端半导体清洗设备扩产升级及研发中心建设。

公司基于现有业务基础扩充产能，并升级产品结构，布局12寸晶圆清洗设备等高端产品，同时建设研发中心以扩大研发团队和增强研发实力。公司拟建设项目实施地点位于上海市奉贤区金汇镇金发路北侧金闸公路东侧，该地块总用地面积约24亩，用地性质为工业用地。本次拟建设投资项目用地所涉及地块符合上海市奉贤区金汇镇用地规划，符合产业政策、土地政策。

### 三、对公司的影响

本次签署的项目投资协议书符合公司战略发展规划，该项目投产后有利于公司进一步扩大规模，提高产能，增强公司竞争力，有利于公司长期发展。以上项目投资协议书的签署和履行符合公司长远战略布局和全体股东的利益，对公司的经营业绩及长远发展产生积极影响。

### 四、风险提示

在协议履行过程中，国家法律法规及政策的变化、协议双方情况的变化可能会影响协议的履行，该项目投资协议书的签署不构成对公司业绩的承诺，特此提醒广大投资者注意投资风险。

### 五、备查文件

（一）经与会董事签字的《上海提牛科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

（二）拟签署的《投资协议书》

上海提牛科技股份有限公司

董事会

2024年3月7日